

1. 언더필(Underfill)이란?

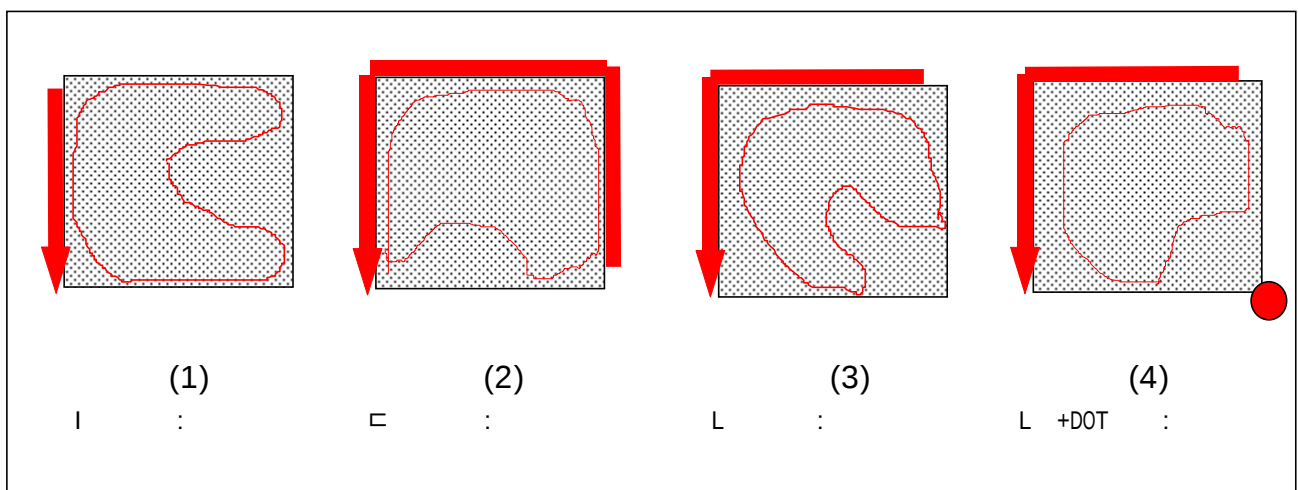
Package BGA, CSP, Flip Chip

2. 언더필을 굳이 해야할 필요가 있나요?

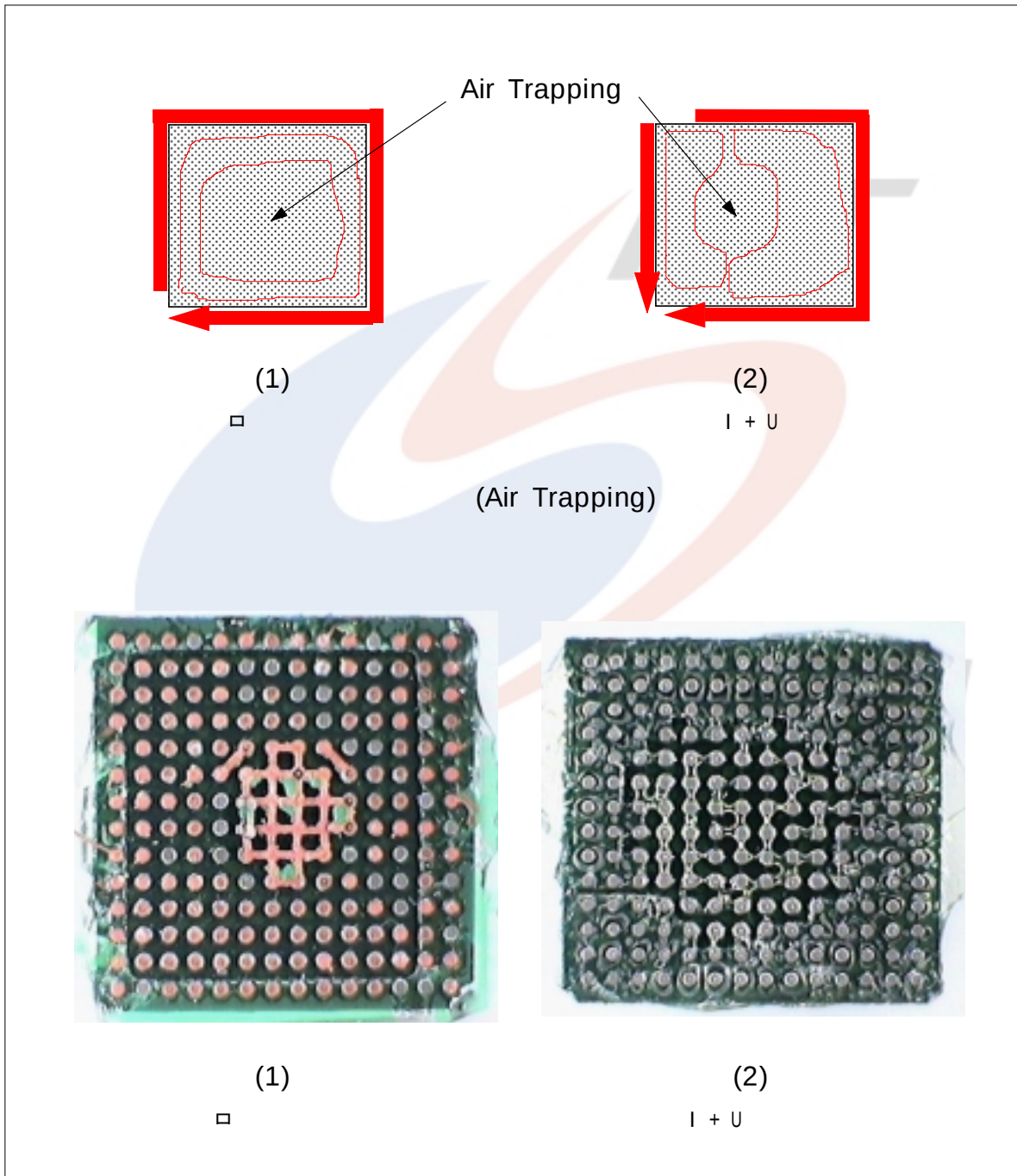
가

- 1)
 - PCB (가)
 - PCB (PCB) 가
- 2)
 - /
 - Migration (Flip Chip
 - α -ray)

3. 언더필 방법



가
가 Package
가
Air
Air Trapping
가
Air Trapping
가
Air가
Air Trapping



4. 언더필 재료 및 장치

1)

가
(/)
(/)가
/ ()
Syringe 가 .
Repair가 .

2)

가 가 .
가 가 .
Array 가 .
PCB 가 .
Multi -Nozzle 가 .

3)

In -Line Off -Line 가 .
Off -Line Chamber PCB
Magazine .
In -Line Vertical Type 가 .

5. 언더필이 잘 되지 않을 때 Check Point

Package	PCB	Gap	가? → Gap	Filler Size
Flux	가		가? →	Solder Paste
	PCB	가 60	~ 80	가?
Underfill			가?	
Underfill		가		가?
PCB		PCB	Gap	가?
		가?		